

## 國立臺灣科技大學工程學院半導體產業學程（研究所）修讀辦法

102年6月4日第168次教務會議通過  
105年6月7日第182次教務會議通過  
111年2月10日第工程學院第98次課程委員會議通過  
112年5月19日111學年度工程學院第5次課程委員會議通過  
112年11月29日112學年度工程學院第2次課程委員會議通過  
113年5月14日112學年度工程學院第4次課程委員會議通過

- 一、凡本校、臺灣大學及臺灣師範大學三校研究生皆可修讀本學程。
- 二、招收名額：不限制（但仍受課程之選修人數限制）。
- 三、申請方式：應於本校行事曆規定期間提出申請。
- 四、最低修習學分總數：附表所列科目至少十二學分。
- 五、應修科目及學分數：如附表。
- 六、學生修習本學程課程，應於每學期加退選期間內辦理之。
- 七、學生修習本學程課程之學分併入各系規定之畢業最低總學分數內，並併入每學期修習之學分上限內。
- 八、學生修畢本學程應修課程且成績及格者，應於畢業前填具申請表，並檢附歷年成績單影本，依規定時限提出申請，經工程學院半導體產業學程審查委員會審查通過後，由學院發給學分學程修業證明。
- 九、有關外校學生申請修讀相關事宜，悉依本校公告資訊辦理。
- 十、本辦法未規定之事宜，悉依本校學則及相關法令之規定辦理。
- 十一、本辦法經本校教務會議通過後報請校長核定後實施，修正時亦同。

附表 半導體產業學程（研究所）應修科目及學分數

課程名稱（任選四(含)以上）	開課系所	學分
半導體元件理論	電子系	3
半導體元件製造工程	電子系、光電所	3
類比積體電路分析與實作	電機系	3
嵌入式作業系統實作	電機系	3
嵌入式微處理器系統設計	電機系	3
嵌入式系統軟體設計	電機系	3
創意性機構設計	機械系	3
光機電工程學	機械系	3
真空薄膜工程	機械系/材料系/化工系	3
高等材料熱力學	材料系	3
穿透式電子顯微鏡	材料系	3
積體電路製造程序與設備	材料系/機械系	3
半導體元件之製造技術	化工系	3
自動化感測與智慧資料擷取	自控所	3

課程名稱 (任選四(含)以上)	開課系所	學分
微影光學	自控所	3
微奈米製造技術	機械系	3
半導體製程設備與技術	自控所	3
電力電子應用	電機系	3
智慧精微及半導體製造(一)	機械系	3
智慧精微及半導體製造(二)	機械系	3
光電半導體材料製造技術	機械系	3
計算機演算法	電子系	3

學分學程修業證明申請時間：

本校行事曆記載之教師送繳成績截止日起(不含)，15曆日內依相關規定提出申請。